

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成21年7月23日(2009.7.23)

【公表番号】特表2008-544555(P2008-544555A)

【公表日】平成20年12月4日(2008.12.4)

【年通号数】公開・登録公報2008-048

【出願番号】特願2008-518423(P2008-518423)

【国際特許分類】

H 01 L 31/04 (2006.01)

【F I】

H 01 L 31/04

【手続補正書】

【提出日】平成21年6月3日(2009.6.3)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

メッシュパターンの形成された第1の表面を有するダイを提供する工程と、

第1の層の表面によって支持される金属層を含む第1の物品を提供する工程と、前記金属層は第1の形状であることと、

第1の層と異なる第2の層によって支持される光活性材料を含む第2の物品を提供する工程と、

第2の物品とダイとの間に第1の物品を配置する工程と、

第1の物品が第2の物品とダイとの間にあるときに、金属層が第1の形状から第1の形状と異なる第2の形状である金属メッシュへ変化するように第1の層の前記表面とダイの第1の表面とを接触させることによって、金属メッシュ、光活性材料、および第2の層を含む第3の物品を形成する工程を含む方法。

【請求項2】

ダイの第1の表面が第1の層と接触しているとき、約100以上までダイを加熱する工程を含む請求項1に記載の方法。

【請求項3】

ダイの第1の表面が第1の層と接触しているとき、約300以上までダイを加熱する工程を含む請求項1に記載の方法。

【請求項4】

ダイの第1の表面が第1の層と接触しているとき、ダイに約0.689MPa(約100psi)以上の圧力を加える工程を含む請求項1に記載の方法。

【請求項5】

ダイの第1の表面が第1の層と接触しているとき、ダイに約6.895MPa(約1,000psi)以上の圧力を加える工程を含む請求項1に記載の方法。

【請求項6】

ダイの第1の表面が第1の層と接触しているとき、ダイに約34.47MPa(約5,000psi)以上の圧力を加える工程を含む請求項1に記載の方法。

【請求項7】

第2の物品とダイとの間に第1の物品を配置する前に、金属層と第1の層との間に放出層を配置する工程を含む請求項1に記載の方法。

【請求項 8】

放出層はポリエステルまたはポリエチレンを含む請求項 7 に記載の方法。

【請求項 9】

金属層は、アルミニウム、鉄、金、銀、銅、ニッケル、パラジウム、白金、チタンまたはそれらの合金を含む請求項 1 に記載の方法。

【請求項 10】

第 3 の物品は、基板と金属メッシュとの間に光活性材料を含む光電池を含む請求項 1 に記載の方法。

【請求項 11】

ダイの第 1 の表面のうちの少なくとも一部は平坦面または湾曲面である請求項 1 に記載の方法。

【請求項 12】

第 1 の層および第 2 の層のうちの 1 つ以上はフレキシブル基板を含む請求項 1 に記載の方法。